

RJ45C5E R1D 3.2N4G/Y TY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Asortyment produktów obejmuje następujące konstrukcje:

- 90°, leżąca (pozioma) oraz 180°, stojąca (pionowa)
- górny zatrzask / dolny zatrzask
- Procesy lutowania THT, THR lub SMD
- Szeroki wybór różnorodnych konstrukcji, także z wbudowanymi kontrolkami LED oraz zaciskami ekranu
- Kategoria działania Cat. 3 do Cat. 6
- Pakowane na tacy (TY) lub na rolce (taśma na szpuli, RL)
- Kompatybilny ze złączem modułowym RJ45, zgodnie z ANSI / TIA-1096-A oraz IEC 60603
- Wytrzymałość dielektryczna ≥ 1500 V AC RMS (wartość szczytowa 2250 V AC) zgodnie z IEEE 802.3
- Wytrzymałość dielektryczna ≥ 1500 V AC (wartość szczytowa) lub ≥ 1500 V DC zgodnie z IEC 60603

Właściwości i zalety:

- Rozszerzony zakres temperaturowy od -40° degC do $+85^{\circ}$ degC dla maksymalnej wydajności
- Wzmocniona warstwa złota (30μ) dla lepszego zabezpieczenia przed korozją
- Odstęp minimum 0,3 mm zapewnia idealne rezultaty lutowania

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącze wtykowe do druku, Gniazda RJ45, Cat. 5e, Połączenie lutowane THT/THR, 90°, Opcja zatrzaskiwania: dół, LED: Tak, Liczba biegunów: 8, Taca (montaż ręczny)
Nr zam.	2613200000
Typ	RJ45C5E R1D 3.2N4G/Y TY
GTIN (EAN)	4050118623802
Ilość	600 Szt.
opakowanie	Taca (montaż ręczny)

RJ45C5E R1D 3.2N4G/Y TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	21,27 mm	Głębokość (cale)	0,837 inch
Masa netto	1,615 g	Najmniejsza wysokość montażu	13,45 mm
Szerokość	15,88 mm	Szerokość (cale)	0,625 inch
Wysokość	13,45 mm	Wysokość (cale)	0,53 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość napięciowa styk / ekran	1500 V DC	Wytrzymałość napięciowa styk / styk	1000 V DC
napięcie znamionowe	125 V		

Specyfikacje systemu

Długość pinu do lutowania (l)	3,2 mm	Ekranowanie	Tak
Kategoria	Cat. 5e	Klasa mocy	Cat. 5e
LED	Tak	Liczba biegunów	8
Opcja zatraskiwania	dół	Powierzchnia ekranu	niklowany
Proces lutowania	Lutowanie rozpliwowe, Lutowanie ręczny, Lutowanie falowe	Raster w mm (P)	1,27 mm
Rodzina produktów	OMNIMATE Data - gniazdo modułowe RJ45	Stopień ochrony	IP20
kąt odejścia	90°	montaż na płytce drukowanej	Połączenie lutowane THT/ THR

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny	PA 9T	Barwny	czarny
Tabela kolorów (podobny)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	1
Klasa palności wg UL 94	V-0	Powierzchnia styku	Złoto na niklu
Temperatura magazynowania, min.	-40 °C	Temperatura magazynowania, max.	85 °C
Temperatura pracy, min.	-40 °C	Temperatura pracy, max.	85 °C

Opakowanie

opakowanie	Taca (montaż ręczny)	Długość VPE	365 mm
Szerokość VPE	275 mm	Wysokość VPE	30 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog [Catalogues in PDF-format](#)

RJ45C5E R1D 3.2N4G/Y TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

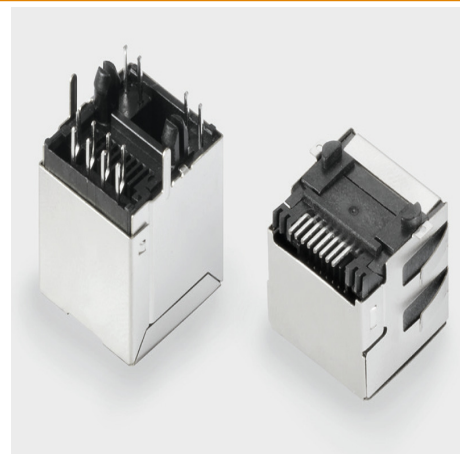
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Zaleta produktu

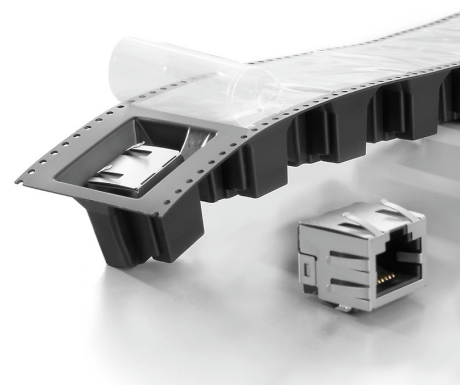


Zaleta produktu



Suitable for all soldering processes
SMT, THT or THR

Zaleta produktu

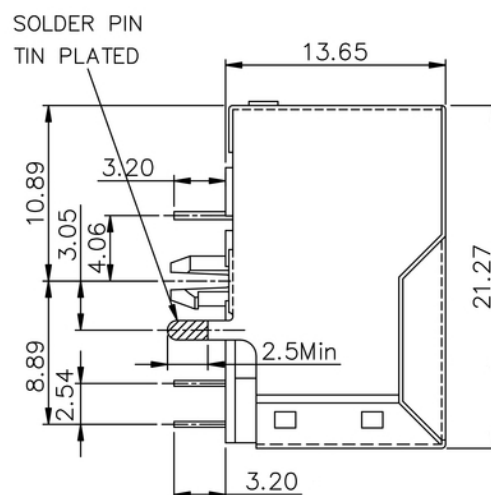
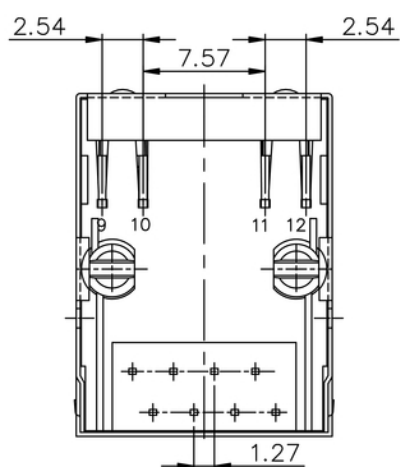
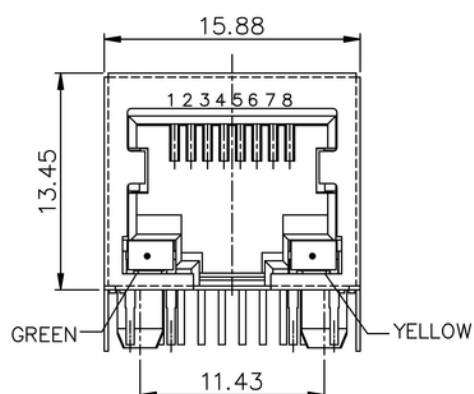
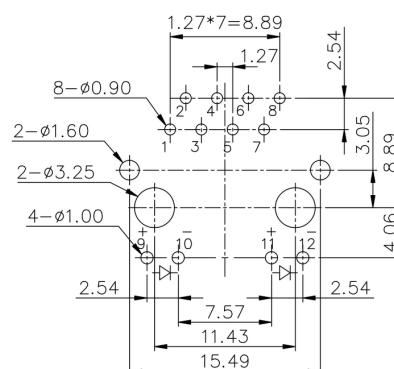


RJ45C5E R1D 3.2N4G/Y TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



RJ45C5E R1D 3.2N4G/Y TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

RJ45	G1	R1	U1	U2	E4	GY/GY	TY	RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY
							Packaging	TY RL
							LED	Y/G G/Y GY/GY O/R R/O ... N
							Contact surface thickness	4
							EMI tabs (ground fingers)	E N
							Solder Pin length	3.2 1.6 D
							Direction, latch style	U D V Y
							Number of Ports	1 Port 12; 14; ... 21; 41; ...
							Assembly on PCB	R S T
							Performance Category	C5 C6 C6A C5e M G1 G10 U MP MP+

Legenda

Data sporządzenia 15 kwietnia 2021 05:02:19 CEST

Aktualizacja katalogu 09.04.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

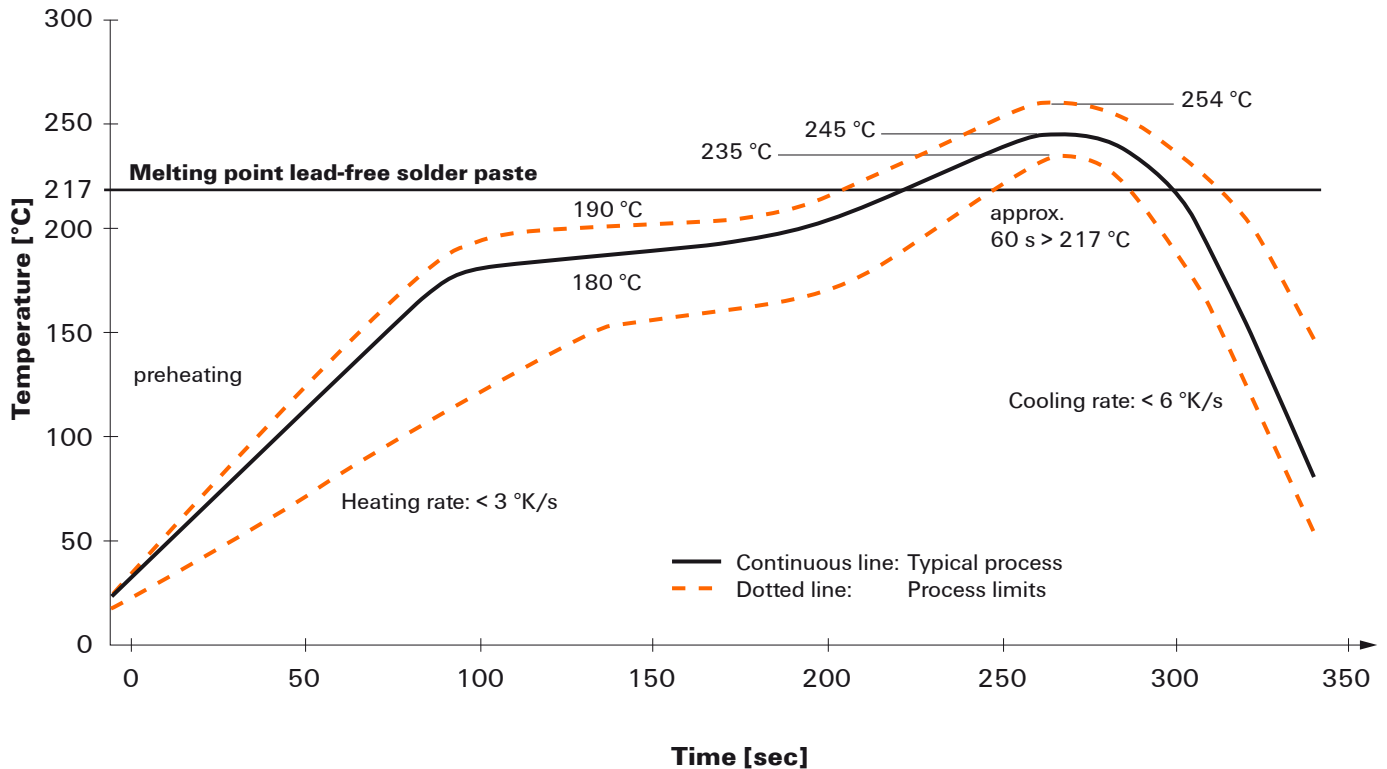
- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.